Příloha č. 1 - Specifikace předmětu veřejné zakázky

|  |  |
| --- | --- |
| **Paměťové moduly – 288 kusů**  | **Splněno** |
| **Parametr** | **Specifikace – minimální požadavek zadavatele** | **Ano / Ne**  |
| Specifikace paměťového modulu | Dell 16 GB Certified Memory Module - 2RX4 DDR3 RDIMM 1600MHz LV |  |
| Implementační práce | * Je požadována montáž jednotlivých paměťových modulů do jednotlivých ESXi serverů dle seznamu ESXi serverů v Tab. 2
* Součástí implementačních prací bude návrh rozmístění pořizovaných paměťových modulů do jednotlivých serverů s ohledem na dosažení maximální kapacity operační paměti napříč virtualizační farmou a co nejrovnoměrnějším rozložením velikosti cílové operační paměti mezi jednotlivými ESXi servery při dodržení veškerých technických specifikací výrobce serverů. V rámci návrhu rozmístění budou přípustné změny rozmístění, jako je zejména přesun stávajících modulů mezi servery, za účelem dosažení optimálního využití paměťových modulů.
 |  |

*Tab. 1: specifikace poptávaných paměťových modulů*

Vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření pamětí virtualizační farmy u již existujících serverů, je pro správný chod těchto serverů nutno dodržet konfigurační možnosti dané výrobcem serverů a aktuálních konfigurací jednotlivých ESXi serverů, tak aby byly dodrženy veškeré výkonnostní a konfigurační doporučení výrobce. Pro zajištění spolehlivého chodu serverů, které jsou kritickým prvkem informační infrastruktury zadavatele zajišťujícím provoz kritických informačních systémů státu, není možno vstupovat do rizika a nedodržet technická doporučení výrobce serverů a kombinovat různé velikosti modulů, necertifikované moduly a řadu dalších technických omezení. Z tohoto důvodu je poptáván konkrétní typ paměťového modulu, a to v souladu s § 89 odst. 5 ZZVZ, neboť takový postup je odůvodněn předmětem veřejné zakázky.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Server** | **CPU** | **Současná konfigurace RAM** |
|  | **Jméno** | **Model** | **Service Tag** | **Počet** | **Typ** | **Kapacita** | **Velikost DIMM** | **Počet DIMM** | **Frekvence** |
| ESX PIC | Server 1 | R920 | 5VKRT72 | 4 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4830 v2 @ 2.20GHz | 256 GB | 16 GB | 16 | 1600 MHz |
| Server 2 | R920 | 5VKQT72 | 4 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4830 v2 @ 2.20GHz | 256 GB | 16 GB | 16 | 1600 MHz |
| Server 3 | R910 | FXG3ZZ1 | 4 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 4830 @ 2.13GHz | 256 GB | 16 GB | 16 | 1333 MHz |
| Server 4 | R910 | BXG3ZZ1 | 4 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 4830 @ 2.13GHz | 256 GB | 16 GB | 16 | 1333 MHz |
| Server 8 | R910 | 85LDF02 | 4 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 4860 @ 2.27GHz | 256 GB | 8 GB | 32 | 1600 MHz |
| ESX ZIC | Server 9 | R920 | 5VJXT72 | 4 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4830 v2 @ 2.20GHz | 256 GB | 16 GB | 16 | 1600 MHz |
| Server 10 | R920 | 8KQXT72 | 4 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4830 v2 @ 2.20GHz | 256 GB | 16 GB | 16 | 1600 MHz |
| Server 11 | R920 | 5VKVT72 | 4 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4830 v2 @ 2.20GHz | 256 GB | 16 GB | 16 | 1600 MHz |
| Server 12 | R920 | 8KQVT72 | 4 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4830 v2 @ 2.20GHz | 256 GB | 16 GB | 16 | 1600 MHz |
| Server 13 | R920 | 5VKTT72 | 4 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4830 v2 @ 2.20GHz | 256 GB | 16 GB | 16 | 1600 MHz |
| Server 14 | R920 | 8KRNT72 | 4 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4830 v2 @ 2.20GHz | 256 GB | 16 GB | 16 | 1600 MHz |
| Server 15 | R920 | 8KRQT72 | 4 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4830 v2 @ 2.20GHz | 256 GB | 16 GB | 16 | 1600 MHz |
| Server 16 | R920 | 8KQWT72 | 4 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4830 v2 @ 2.20GHz | 256 GB | 16 GB | 16 | 1600 MHz |
| **ESX SQL PIC**  | Server 17 | R910 | 26LDF02 | 4 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 4860 @ 2.27GHz | 256 GB | 8 GB | 32 | 1600 MHz |
| Server 18 | R910 | 76LDF02 | 4 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 4860 @ 2.27GHz | 256 GB | 8 GB | 32 | 1600 MHz |
| **ESX SQL ZIC** | Server 19 | R920 | 5VKPT72 | 4 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4830 v2 @ 2.20GHz | 256 GB | 16 GB | 16 | 1600 MHz |
| Server 20 | R920 | 8KRPT72 | 4 | Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4830 v2 @ 2.20GHz | 256 GB | 16 GB | 16 | 1600 MHz |

*Tab. 2: seznam ESXi serverů do kterých budou umístěny paměťové moduly*